

2019年10月1日

日清エンジニアリング「JAPAN PACK 2019」に初出展 ～マトコン・コンテナ（IBC）システムをご提案～

日清製粉グループの日清エンジニアリング株式会社（社長：村田 博）は、本年10月29日（火）～11月1日（金）の4日間、幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区）で開催される「JAPAN PACK 2019（日本包装産業展）」に初出展します。

■マトコン・コンテナシステムを使用したプラント設備を提案（当社ブース：6H-07）

当社ブースでは、多品種少量生産に適したバッチ連続システムである「マトコン・コンテナ（IBC）システム」を使用したプラント設備をはじめ、食品・粉体等の工場トータルエンジニアリングについてご提案します。

「マトコン・コンテナ（IBC）システム」は、当社が2002年から英国マトコン社のエンジニアリング・パートナーとしてお客様へ導入させていただいている粉粒体用容器システムです。これまで、食品・医薬のみならず、化学、金属粉体や電子・電池材料粉体など、幅広い分野で採用されています。



《主な出展内容》

■粉粒体コンテナシステム「マトコン」

少量多品種の粉体を取り扱う工場において、衛生的な環境を保ちながら、柔軟かつスピーディーに品種切り替えができるマトコン・コンテナ（IBC）システムについて、事例を交えながらご紹介いたします。

■食品・粉体工場トータルエンジニアリング

食品工場建設や粉体プラント施工のプロジェクトについて、取り組み方や進め方のポイントを、生産設備と建屋を最適化した“トータルエンジニアリング”という視点からご紹介いたします。

■「JAPAN PACK 2019（日本包装産業展）」概要

- ・会 期：2019年10月29日（火）～11月1日（金）10：00～17：00
- ・会 場：幕張メッセ 国際展示場 2～8ホール（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）
- ・主 催：一般社団法人日本包装機械工業会
- ・Webサイト：<https://www.japanpack.jp/>

以上

この件に関する報道関係者のお問い合わせ先

株式会社日清製粉グループ本社 総務本部 広報部 担当：開^{ひらき}・塩谷

【電話】03-5282-6650 【メール】mailbox@mail.nisshin.com